公司代码:688020　　公司简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者,在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下,公司 2024 年年度利润分配方案如下:公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8676 元(含税)。截至 2025 年 4 月 10 日,公司总股本 80,747,998 股,以扣减回购专用证券账户中股份总数 430,733 股后的股本 80,317,265 股为基数,预计派发现金红利 15,000,000 元(含税),本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

本利润分配预案尚需 2024 年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王作凯	赵曦
联系地址	广州市黄埔区东校路 28 号	广州市黄埔区东校路 28 号
电话	020-82512686	020-82512686
传真	020-32203005	020-32203005
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案,现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻薄膜等。

其中电磁屏蔽膜、标准电子铜箔(以下简称“标箔”)是公司报告期内的主要收入来源。

2、主要产品及服务情况

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别、具有复杂结构的薄膜,具有抑制电子元器件电磁干扰的功能,通过贴合于 FPC 产生作用。现代电子产品“轻薄短小”和高频高速化趋势更加明显,驱动着电子元器件及其组件内外部的电磁干扰、以及信号在传输中衰减问题逐渐严重,对电磁屏蔽膜的需求更大,同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为 HSF6000 和 HSF-USB3 两大系列。其中 HSF-USB3 系列是 2014 年推出的新型电磁屏蔽膜,具备自主研发的独特微针型结构,屏蔽效能进一步提高,同时可大幅降低信号传输损耗,降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

(2)铜箔产品

报告期内,公司铜箔产品主要包括带载体可剥离超薄铜箔(以下简称“可剥铜”)、各类电子铜箔。

带载体可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板、HDI 板的必需基材。目前 IC 载板、类载板的线宽线距已细至 10/10μm-40/40μm,用传统的减成法制程工艺无法制备,主要使用 mSAP(半加成工艺),而 mSAP 必须使用可剥铜。公司生产的可剥铜具有厚度极薄、表面轮廓极低、载体层和可剥离层之间的剥离力稳定可控等特性,可满足 mSAP 的制程要求。

电子铜箔是制造覆铜板(CCL)、挠性覆铜板(FCCL)、印制电路板(PCB)、柔性电路板(FPC)的主要原材料,主要有高温高延伸铜箔(HTE 箔,主要应用于多种类常规覆铜板及线路板)、反转处理铜箔(RTF 箔,主要应用于高频高速板)和低轮廓铜箔(VLP 箔,主要应用于高频高速、低损耗要求的电路板)等。公司生产的各类电子铜箔,厚度、延伸性、面密度、耐热性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

(3)挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)是 FPC 的加工基材,由挠性绝缘层与金属箔构成。根据产品结构,挠性覆铜板可分为有胶三层挠性覆铜板(3L-FCCL)和无胶两层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据产品厚度,每类挠性覆铜板又分为普通型和极薄型。

下游电子产品快速发展,推动 FPC 制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对 FPC 的高密度互连(HDI)技术要求也不断提高。FCCL 是实现高密度互连技术的关键材料之一,可大幅提升电子元器件组装密度并节约组装空间,并实现超细线路 FPC 的制备。公司采用自研自产原材料(主要是 RTF 铜箔和 PI/TPI)的技术路径生产 FCCL,可降低生产成本,同时实现其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标满足下游需求,具有良好的加工性能。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式,由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况,确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行 ISO9000 标准,采购价格确定方式主要采用询价模式。

2、生产模式

公司采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式,由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标,生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司电磁屏蔽膜核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等,铜箔生产核心环节为溶铜、生箔、后处理等,挠性覆铜板生产核心环节包括混胶合成、涂布、真空溅射、压合等。公司的产品为高端电子材料,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,上述生产环节均由公司自主完成,不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测,并对最终产品进行质量检验。

3、销售模式

报告期内,公司的销售模式为直销模式,直接客户为线路板厂商和覆铜板厂商,最终用户为智能手机、平板电脑以及汽车行业等品牌厂商。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况,自行针对目标市场进行产品开发,为下游客户提出解决方案;另一方面,公司和下游客户以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系,形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后,由下游客户进行打样、工艺验证和基本性能测试,通过后由封装 / 终端品牌厂商进行整体性能测试,之后通过小批量试产,验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致,公司即可量产、销售。

4、研发模式

公司长期坚持自主创新,采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面,通过与下游终端厂商的技术交流,了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜、超薄铜箔、挠性覆铜板等产品的个性化需求,进行定制式研发。在主动式研发方面,采用自主研发的设备,依靠自身积累的经验,根据市场需求,设计产品,生产部门配合研发实验室进行测试确认,不断优化实验方案,不断改进,最终确定方案进行小批量试产,试产成功后再进行大批量生产,逐步提升现有产品的性能。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

(2)行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如芯片封装、高性能高精密线路板制备密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成“卡脖子”困境。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。2018 年颁布的《战略性新兴产业分类》,明确将“电磁波屏蔽膜”、“高频微波、高密度封装覆铜板”、“PCB 用高纯铜箔”等电子专用材料列为重点产品。

报告期内,公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔,直接下游客户为线路板(PCB)厂商、覆铜板厂商,应用终端场景主要为消费电子,部分应用于汽车电子。

PCB 有“电子产品之母”之称,能实现电子元器件的相互连接,起中继传输作用。近年来,随着 5G 通讯、消费电子、汽车电子等行业的快速发展,PCB 市场规模逐年扩大,根据 Prismark、高工产研(GGII)等机构的统计,2021 年全球 PCB 产值已达 804 亿美元。然而,受全球经济下行、消费需求萎缩等因素影响,PCB 市场需求在 2022 年四季度开始明显疲软,全球电子整机市场新增需求下降,PC、手机、电视等领域受到较大影响,预计 2023 年全球 PCB 产值将同比下滑 15.0%,同时,需求疲软带来的价格压力也令产业链整体盈利能力水平下降。

然而,危机与机遇并存,以 CHATGPT 引发的新一轮人工智能及算力革命,AI PC/AI 手机及 AI 终端问世带来的新一轮消费电子的革新和重构,以及碳中和背景下新能源汽车产业及汽车电子化、智能化和网联化的快速发展,预计将在未来为 PCB 行业带来新一轮成长周期。根据 Prismark 预测,2022 至 2027 年全球 PCB 产值复合增长率为 3.8%,2027 年全球产值将达到 983.88 亿美元;2022 年至 2027 年中国 PCB 产值复合增长率为 3.3%,2027 年产值将达到 511.33 亿美元。

另一方面,回顾整个 PCB 发展历史,全球 PCB 产业初期由欧美国家厂商主导,随着日本 PCB 发展壮大,形成了欧美日共同主导的局面,进入 21 世纪后,亚洲地区由于具有劳动力成本优势,同时下游电子终端产业发展欣欣向荣,能够为 PCB 提供巨大的市场需求支持,因此吸引了全球 PCB 厂商的投资,欧美 PCB 产业大量外迁,全球 PCB 产业重心向亚洲转移,亚洲开始主导全球 PCB 产业,目前形成了以亚洲为中心(尤其是中国大陆)、其他地区为辅的新局面。

PCB 产业在总体体量不断增长、重心不断往中国大陆集聚的同时,还呈现出技术不断升级的特点,表现为挠性板(FPC)、高密度互连板(HDI)、芯片封装基板等高性能电路板需求持续放量,同时埋入式无源元件的市场需求也在逐步显现。据 Prismark 统计及预测,全球 FPC、HDI 和封装基板 2023-2028 年的复合增长率分别为 4.4%、6.2% 和 8.8%,至 2028 年三者产值分别为 151.17 亿美元、142.26 亿美元和 190.65 亿美元。

全球 PCB 产值、技术路线整体呈上升趋势,增大了对公司电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔以及电阻薄膜等产品的市场需求。总体来看,电子专用材料市场增长前景可观,我国高端电子专用材料自给率仍较低,具有很大的成长空间。

(3)主要技术门槛

首先,公司长期深耕消费电子产业链,以电磁屏蔽膜产品为抓手,与华为、三星等世界顶尖企业建立了长期稳定的深度技术交流渠道和机制,可第一时间掌握 5G 通讯、芯片封装、超高清显示等关键行业最新的技术发展趋势及需求。

其次,公司拥有为上述技术发展趋势及需求快速提供相应产品及解决方案的独特能力。这种能力源自于公司拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术,并可实现各技术间的组合创新,这让公司在高端电子材料制造中拥有强强的优势。

原因在于,将导体材料与绝缘材料进行结合,形成高性能复合材料,这是制备高端电子材料的底层技术路径。一方面,通过自主开发的真空溅射、连续卷状电沉积技术,公司可生产各种功能的金属箔,如超薄铜箔、标准铜箔等,其厚度、粗糙度以及表面形貌可定制;另一方面,通过精密涂布以及特殊配方技术,公司可生产绝缘薄膜,例如 PI、TPI 以及 BT 树脂、改性环氧树脂、丙烯酸树脂等。具备以上基础后,通过将金属箔与绝缘膜进行搭配组合,公司可生产各种功能的高端电子材料(薄膜),如铜箔搭配 PI/MPI,制备极薄挠性覆铜板以及特殊结构的复合金属箔、电阻薄膜等,从而快速地、定制化地满足下游终端的最新技术需求。电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程,涉及的原料配方、生产工艺、品质控制均较为复杂,同时下游应用持续对产品提出更高技术需求,企业必须不断改进生产工艺,不断升级、改善自主研发的关键设备和原料配方。随着技术的进步,产品升级速度不断提升,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应市场的发展。

目前公司主要产品关键技术难点及技术壁垒如下:

电磁屏蔽膜:屏蔽效能≥60dB,接地电阻≤200mΩ,同时满足极低插入损耗、轻薄、耐弯折、耐热耐化等严苛加工应用要求;

挠性覆铜板:铜层厚度 2-9μm、12/18/35μm(可定制化),剥离强度≥10N/cm,尺寸稳定性(%)≤±0.08,同时满足耐热耐化等严苛加工应用要求;

带载体可剥离超薄铜箔:主要特点为厚度超薄、表面轮廓极低,铜层厚度 1.5-6μm,铜层粗糙度 0.5-2.0μm,剥离强度≥6N/cm,拉伸强度 400N/mm2,延伸率≥5%;

标准铜箔:产品厚度 12-35μm 为主,可定制化,延伸性、面密度、表面粗糙度等符合客户要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司在行业内拥有较强技术水平,部分产品对标国外,满足供应链本土化

在电磁屏蔽膜领域,公司具有重要的市场、行业地位,市场占有率较高。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。

在挠性覆铜板领域,其主要原材料是铜箔、聚酰亚胺(PI)和热塑性聚酰亚胺(TPI),公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板,以逐步打破对国外上游供应链的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅降低生产成本,提升产品市场竞争力和经济效益。另一方面,制备极薄挠性覆铜板等高端产品,对铜箔厚度、粗糙度以及产品整体剥离力等要求很高,公司现有的技术、工艺和配方可满足以上技术需求。对于极薄挠性覆铜板,目前该产品全球量产供应商主要为日本的东丽和住友。公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板,其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进,具有优异的加工性能。

在超薄铜箔领域,公司生产的带载体可剥离超薄铜箔,目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔,其铜层厚度及表面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等关键指标达到世界先进水平。

(2)公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立了稳定的合作关系

凭借良好的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应,公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex 等众多优质直接客户,并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切的技术交流与合作。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜将受益于 5G-5.5G-6G 通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展。5G-5.5G-6G 环境下,以智能手机、AR/VR 硬件设备为代表的消费电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,其内部结构 FPC 使用量不断增加以提升内部组装密度,同时电子元器件之间的电磁干扰亦愈加严重,这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加,另一方面体现为电磁屏蔽膜性能提升的要求(如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗撕裂性更强等)。

折叠手机、AI 手机也对电磁屏蔽膜提出了新的需求。折叠手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折。AI 手机方面,据市场分析机构 Canalys 最新预测数据显示,2024 年全球 AI 手机出货量占智能手机总出货量的 16%,到 2028 年这一比例将激增至 54%,年复合增长率(CAGR)为 63%,AI 手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题,要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能。

在国家“碳达峰、碳中和”目标提出之后,我国新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化趋势明显。随着汽车向电动化、智能化发展,FPC 在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现,FPC 在车载领域的用量不断提升,应用涵盖显示模组、车灯、BMS/VCU/MCU 控制系统、传感器、自动驾驶辅助系统等相关场景,市场预计单车 FPC 用量将超过 100 片。在上述 FPC 应用场景中,又因显示模组有其高清化需求,以及传感器系统需要接收 5G 信号、毫米波等高频高速信号以实现短延迟甚至零延迟的探测反馈和自动驾驶,这些高频高速电路存在对电磁屏蔽的潜在需求。

(2)挠性覆铜板

作为 FPC 的加工基材,挠性覆铜板将受益于 FPC 市场需求扩大及其细线化趋势。据市场分析机构 Prismark 数据及预测,近 10 年内,全球 FPC 产值规模不断扩张,复合增长率约 3.3%,预计 2028 年全球 FPC 产值有望达到 151.17 亿美元;另一方面,各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,倒逼 FPC 线宽线距越来越精细,这加大了对高性能挠性覆铜板(如无胶二层 FCCL、极薄 FCCL)的需求,因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高,更能满足细线路 FPC 的加工制程。

另外特别值得注意的是新能源汽车对 FPC 的需求不断增大,对上游基材挠性覆铜板形成较强利好。一方面,动力电池 FPC 替代铜线线束趋势明确。相较铜线线束,FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点,在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势,此外 FPC 厚度薄,电池包结构定制,装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上,自动化程度高,适合规模化大批量生产,FPC 替代铜线线束趋势明确,目前国内动力电池主流厂商已经在 Pack 环节批量化应用 FPC。另一方面,FPC 厂商进一步向下游 CCS(Cells Contact System,集成母排,线束板集成件)产品布局,通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成,铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联,FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。

(3)铜箔产品

公司铜箔产品包括带载体可剥离超薄铜箔、标准电子铜箔等。

①带载体可剥离超薄铜箔是芯片封装基板(IC 载板、类载板)、HDI 板的基材,将受益于芯片制程先进化进程。

目前,半导体芯片技术快速发展、制程日益先进,客观上带动芯片封装领域的 IC 载板、类载板的细线化成为必然趋势,目前 IC 载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm,由于其线宽线距极细,用传统的减层法制程工艺无法制备,主要使用 mSAP。mSAP 是制备芯片封装基板、类载板的主流技术路线,目前,鹏鼎控股、深南电路、安捷利-美维电子、三星电机等国内外大型电路板厂商均主要采用 mSAP 制备 IC 载板、类载板等。

一般铜箔无法满足 mSAP 制程要求,必须用到带载体可剥离超薄铜箔。用于 mSAP 工艺的铜箔,必须满足以下关键条件:A.厚度≤3μm,若无法达到该标准,mSAP 将无法稳定“闪蚀”过厚的铜层,届时将依旧存在减成法特有的“侧蚀”现象,无法制作精细线路;B.表面轮廓 Rz≤1.5μm,若无法达到该标准,过高的铜层表面粗糙度闪蚀不掉,无法制作精细线路,同时也会严重影响 IC 载板、类载板的高频高速特性;C.必须带有载体层和可剥离层,由于薄铜太薄,无法直接应用于实际加工,必须依赖载体层加以辅助稳定;同时,实际加工过程中,只有薄铜最终应用到精细线路制作,载体层必须撕掉,因此必须在薄铜与载体层之间设置可剥离层,同时,必须形成剥离力稳定可控的可剥离层,剥离力过高或过低,都将导致实际加工失败,因此剥离力是制备带载体可剥离超薄铜箔的重大技术难点。

当前,国内外高端芯片龙头企业对带载体可剥离超薄铜箔存在较大需求,以实现先进制程芯片与基板的精密互连。然而,带载体可剥离超薄铜箔全球市场被日本三井铜箔垄断,卡脖子问题严重,对与我国高端芯片封装领域密切相关的 5G 通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业造成较大制约,实现带载体可剥离超薄铜箔的供应链本土化需求较为迫切。

②标准电子铜箔领域。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的主要原材料,随着 5G 通讯、计算机、汽车电子、物联网、人工智能、工业 4.0 等不断发展与进步,预计 PCB 产业仍将持续平稳增长,进而推动标准铜箔的发展。高工产业研究院(GGII)预测 2020-2025 年标准铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势,年复合增长率在 7.4% 左右,到 2025 年全球标准铜箔出货量将达 73 万吨,其中对高频、高速、低损耗的高性能铜箔的需求将越来越大,而高频高速铜箔目前我国大部分仍依赖进口,国产化空间广阔。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	1,800,120,282.08	1,945,328,988.11	-7.46	1,968,161,280.36	1,967,930,907.96
归属于上市公司股东的净资产	1,374,196,062.02	1,484,916,098.58	-7.46	1,544,148,205.84	1,544,140,869.74
营业收入	344,570,817.57	345,149,314.31	-0.17	312,626,261.30	312,626,261.30
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	306,986,897.88	329,331,001.93	-6.78	312,068,298.39	312,068,298.39
归属于上市公司股东的净利润	-91,642,742.25	-68,670,118.91	-33.45	-68,024,179.44	-68,018,043.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,768,813.12	-85,851,515.65	-31.35	-82,127,599.77	-82,121,464.29
经营活动产生的现金流量净额	-45,967,720.46	-12,803,081.70	-259.04	113,430,179.14	113,430,179.14
加权平均净资产收益率(%)	-6.43	-4.54	减少 1.89 个百分点	-4.31	-4.31
基本每股收益(元/股)	-1.14	-0.86	-32.56	-0.85	-0.85
稀释每股收益(元/股)	-1.13	-0.85	-32.94	-0.84	-0.84
研发投入占营业收入的比例(%)	17.97	16.10	增加 1.87 个百分点	19.46	19.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	67,434,073.96	81,059,640.80	93,068,105.65	103,008,997.16
归属于上市公司股东的净利润	-14,203,673.80	-7,751,550.96	-17,671,428.98	-52,016,088.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,328,290.92	-13,399,792.67	-22,241,211.14	-55,799,518.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,213,740.40	30,096,321.89	-16,910,673.60	-40,939,628.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,959
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	18.03	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有限公司	0	14,086,260	17.45	0	无	0	境内非国有法人
海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)	0	7,200,000	8.92	0	无	0	境内非国有法人
易红琼	0	4,979,672	6.17	0	无	0	境内自然人
李冬梅	20,379	2,368,089	2.93	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	未知	1,270,383	1.57	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 15 号私募证券投资基金	0	950,000	1.18	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	未知	878,415	1.09	0	无	0	其他
章金楠	287,400	790,000	0.98	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 16 号私募证券投资基金	0	631,800	0.78	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东;苏晓、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏晓与李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙),除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

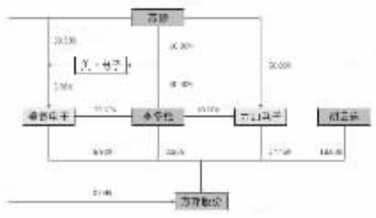
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

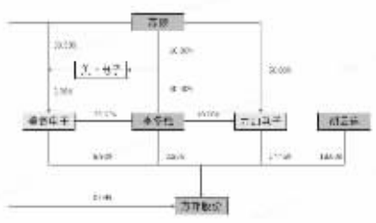
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 34,457.08 万元,较上年基本持平,归属于母公司所有者的净利润 -9,164.27 万元,较上年同期下降 33.45%,主要系:(1)屏蔽膜业务:2024 全年屏蔽膜销量同比增加,但是由于产业链整体降成本、竞争加剧的影响,屏蔽膜销售单价略有下降,屏蔽膜整体盈利能力与去年同比基本持平;(2)铜箔业务:本报告期铜箔业务计提固定资产减值准备 1566.78 万元,同时在电子铜箔行业竞争进一步加剧的环境下,公司在提升产品良率、调整产品结构、主动控制产品出货量、降低生产成本等方面采取了一系列措施,并积极开发、销售 RTF 等毛利较高的铜箔产品,促使铜箔业务整体的亏损有所减少。(3)挠性覆铜板业务:本报告期挠性覆铜板销量大幅增长,作为行业新进者,为了开拓市场,销售单价较低,未达到规模经济,叠加固定资产折旧影响,挠性覆铜板业务尚处于亏损状态。(4)公司持续开展研发投入,报告期内新产品开发认证取得了一系列重要进展,如相关型号可剥铜已经通过部分载板厂商和主要芯片终端认证并获得了小批量测试订单,AI 服务器高速铜缆屏蔽用铜箔产品关键技术指标获客户认可,柔性屏蔽罩已进入某主流品牌手机终端供应链等。然而,由于公司研发产品为基础复合电子材料,整体开发认证周期长,订单放量、稳定生产以及提升良率都需要时间,因此新产品显性贡献业绩尚需时间。(5)公司对报告期内可能发生信用减值损失的应收账款单项计提信用减值,影响本期归属于母公司所有者净利润 1390.45 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2025-016

广州方邦电子股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 2 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024 年度业绩快报公告》(公告编号:公告编号:2025-013),现对相关内容修正如下,财务数据经会计师事务所初步审计,具体以公司披露的 2024 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	34,407.78	34,457.08	34,514.93	-0.17%
营业利润	-7,525.21	-8,968.27	-6,529.95	-37.34%
利润总额	-7,531.85	-8,974.90	-6,826.89	-31.46%
归属于母公司所有者的净利润	-7,719.85	-9,164.27	-6,867.01	-33.45%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-9,832.45	-11,276.88	-8,585.15	-31.35%
基本每股收益(元)	-0.96	-1.14	-0.86	-33.27%
加权平均净资产收益率	-5.39	-6.43	-4.54	减少 1.89 个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	181,456.19	180,012.03	194,532.90	-7.46%
归属于母公司的所有者权益	138,864.03	137,419.61	148,491.61	-7.46%
股本	8,074.00	8,074.00	8,062.84	0.14%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	17.20	17.02	18.42	-7.58%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上数据以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司 2024 年年度报告为准。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报修正原因说明

(一)业绩快报差异情况

本次业绩快报修正是根据注册会计师预审结果进行的修正,修正后营业利润和利润总额与原披露结果差异幅度超过 10%,具体如下:

修正后的营业利润为 -8,968.27 万元,比修正前亏损增加 1,443.05 万元,差异率为 -19.18%;修正后的利润总额为 -8,974.90 万元,比修正前亏损增加 1,443.05 万元,差异率为 -19.16%。

(二)造成上述差异的主要原因

根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度,为真实反映公司的财务状况和资产价值,结合公司的业务实际,本着谨慎性原则,公司对可能发生信用减值损失的应收账款单项计提信用减值准备,相应减少公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 13,904,515.59 元人民币。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度单项计提信用减值准备的公告》(公告编号:2025-015)。

(三)与年审会计师事务所沟通情况

就上述造成业绩快报修正的事项,公司与年审会计师不存在分歧。

二、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2024 年度主要财务数据系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果,具体准确的财务数据请以公司正式披露的 2024 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。因本次修正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2025-017

广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长苏晓先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中,董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业总收入 34,457.08 万元,同比下降 0.17%;实现归属于母公司所有者的净利润 -9,164.27 万元,同比亏损增加 2,297.26 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -11,276.88 万元,同比亏损增加 2,691.73 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规,勤勉尽责,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作能力,督促